

株式会社東京精密 2019年度(2020年3月期) 決算説明資料

2020年5月11日

*

◆ **将来の事象に係わる記述に関する注意**

- 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ **表記データ・用語について**

- 注記がある場合を除き、**半導体製造装置セグメント**を「半導体」、**精密計測機器セグメント**を「計測」、また**親会社株主に帰属する当期純利益**を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ **監査について**

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

決算説明電話会議 次第

- ◆ 2019年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2年目総括
- ◆ 中期目標 最終年度にあたって
- ◆ 2020年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

- 当社 電話会議参加者
 - 代表取締役社長CEO 吉田 均
 - 代表取締役副社長COO 木村 龍一
 - 代表取締役CFO 川村 浩一

2019年度 連結業績



通期業績(億円)	2018年度		2019年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	989		876		-11%
売上高	1,015		879	+19	-13%
営業利益 (営業利益率)	202 (20%)		123 (14%)	+3	-39%
経常利益	208		124	+3	-41%
当期純利益	147		72	-18	-51%
1株配当	125円(普通配105円, 記念配20円)		76円	±0円	-49円

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	282	290	240	177	187	196	225	268	+19%	+51%
売上高	198	314	237	266	180	240	222	237	+7%	-11%
営業利益 (営業利益率)	31 (16%)	71 (23%)	48 (20%)	52 (20%)	18 (10%)	38 (16%)	34 (15%)	33 (14%)	-2%	-36%
経常利益	34	74	48	52	19	38	34	32	-7%	-39%
当期純利益	26	53	35	33	14	29	23	6	-73%	-81%

- 将来の半導体キャパ増を見込み, 新設する日野工場(半導体) 建設計画を拡充変更
これに伴い, 現状建物の減損による特別損失を4Qに計上

May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

4

- 売上高, 営業利益, 経常利益は公表予想に対し想定線の着地
- 純利益は, 将来の拡張に備えた 既存建物の減損(特別損失)計上により想定を下振れたが, 期末配当はこの影響を除くベースで配当性向35%をベースとした結果 公表予想通り 一株あたり38円, 通期一株あたり76円を予定
- 受注高は, 前年4Qを底に半導体で回復を維持, 想定を上振れ

	半導体製造装置	計測機器
2019年度業績	<ul style="list-style-type: none"> ● 発症地域封鎖, 物流停滞等で一部納入延期 ● 計画に対しての影響軽微 ● 引合は引き続き堅調 	<ul style="list-style-type: none"> ● 影響軽微
2020年度上期への影響	<ul style="list-style-type: none"> ● 現状, 大きな影響は見込んでいないが, 状況悪化・長期化による引合や納入への影響注視 	<ul style="list-style-type: none"> ● 足許で顧客工場操業・納入停止による遅延が見込まれる
営業活動	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外は現地社員+国内からのリモートで対応 	<ul style="list-style-type: none"> ● 顧客工場停止・入場制限等により営業活動に遅れ
保守サービス	<ul style="list-style-type: none"> ● 概ね計画通り対応 	
当社国内拠点	<ul style="list-style-type: none"> ● 工場は通常稼働 一部の部材調達は代替品で対応 ● 検温義務化, 消毒の徹底, 3密環境の排除などを実施 ● 技術・管理・営業で在宅勤務など実施 	
当社海外拠点	<ul style="list-style-type: none"> ● 中国・タイなどの工場は通常稼働 ● 一部の拠点で在宅勤務対応 	

- 新型コロナウイルスにより お亡くなりになられた方に
 謹んでお悔み申し上げます。
 また, 罹患された方に 心よりお見舞い申し上げますとともに,
 一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
- 当社への影響, 対応状況は記載の通り
 - 2019年度は半導体製造装置で一部納入延期が見られた
 - 2020年度予想は上期までの開示にとどめ, 計測事業を中心に影響を見込んでいる
 - 工場は通常稼働, 今後も感染拡大防止に配慮した事業体制としたい

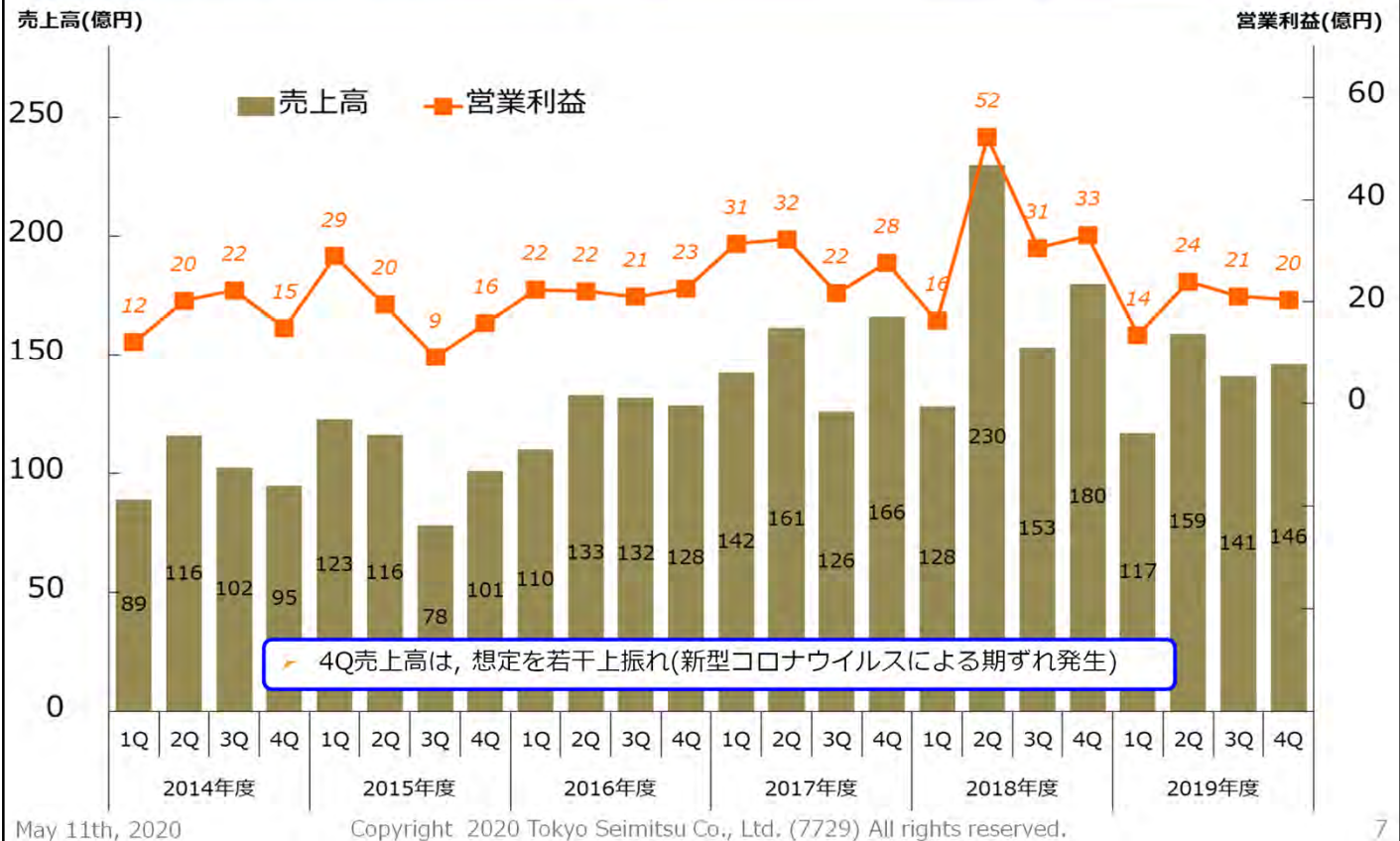
セグメント業績 (通期：億円)	2018年度		2019年度		
	通期		通期	予想対比	前年同期比
受注高	653		577		-12%
売上高	691		562	+12	-19%
営業利益 (営業利益率)	132 (19%)		79 (14%)		-40%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	193	204	151	105	107	122	154	195	+27%	+85%
売上高	128	230	153	180	117	159	141	146	+4%	-19%
営業利益 (営業利益率)	16 (13%)	52 (23%)	31 (20%)	33 (18%)	14 (12%)	24 (15%)	21 (15%)	20 (14%)	-3%	-38%

- 売上高・営業利益は公表対比若干上振れ
- 受注高は期を通じて増加基調を維持

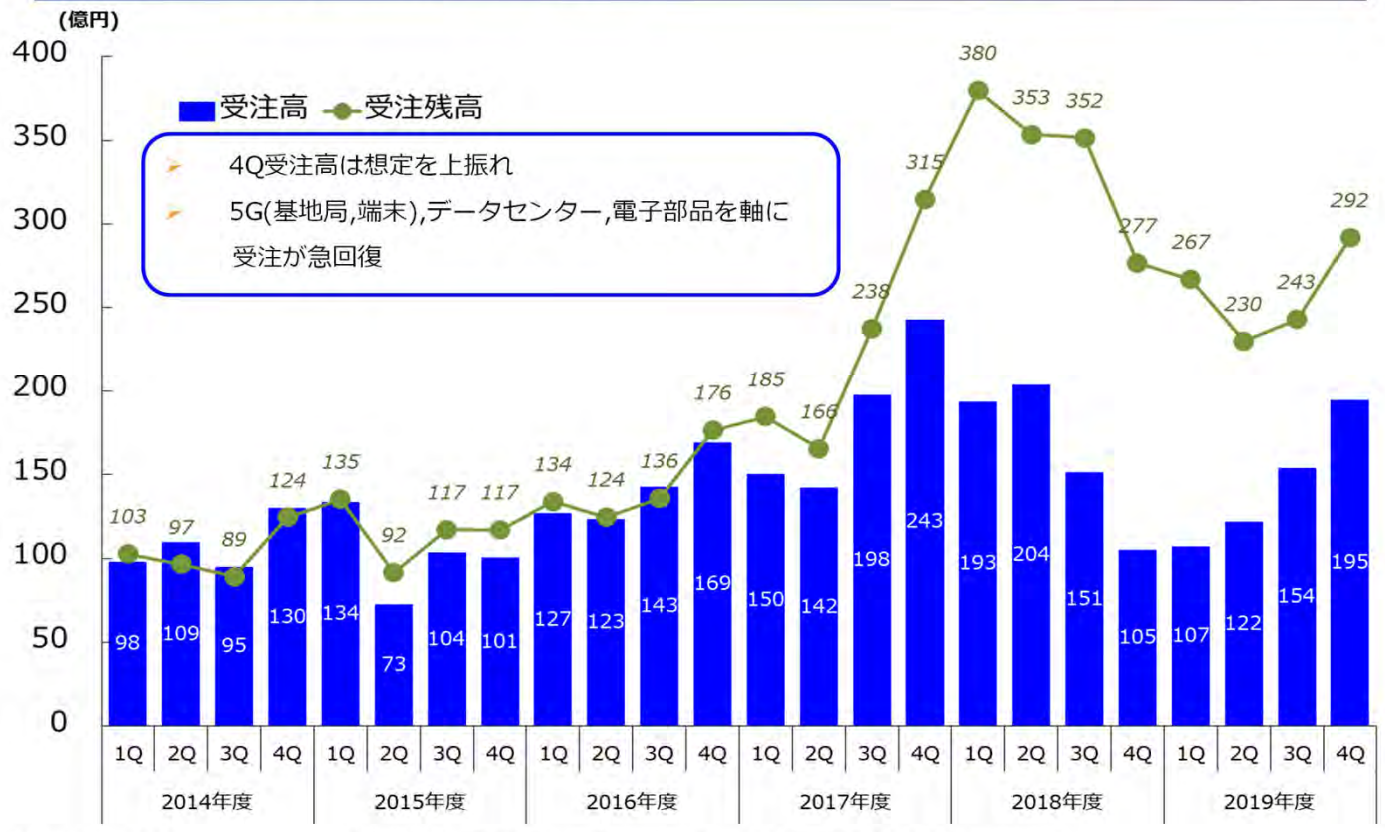
- 2019年度売上高は公表対比で、営業利益は当社想定でそれぞれ若干上振れ
- 受注は、前年4Qを底に半導体で回復を維持、想定を上振れ

半導体 - 売上高, 営業利益



- 2019年度4Qは売上の期ずれ案件が見られたが, 想定を上振れ

半導体 - 受注高, 受注残高



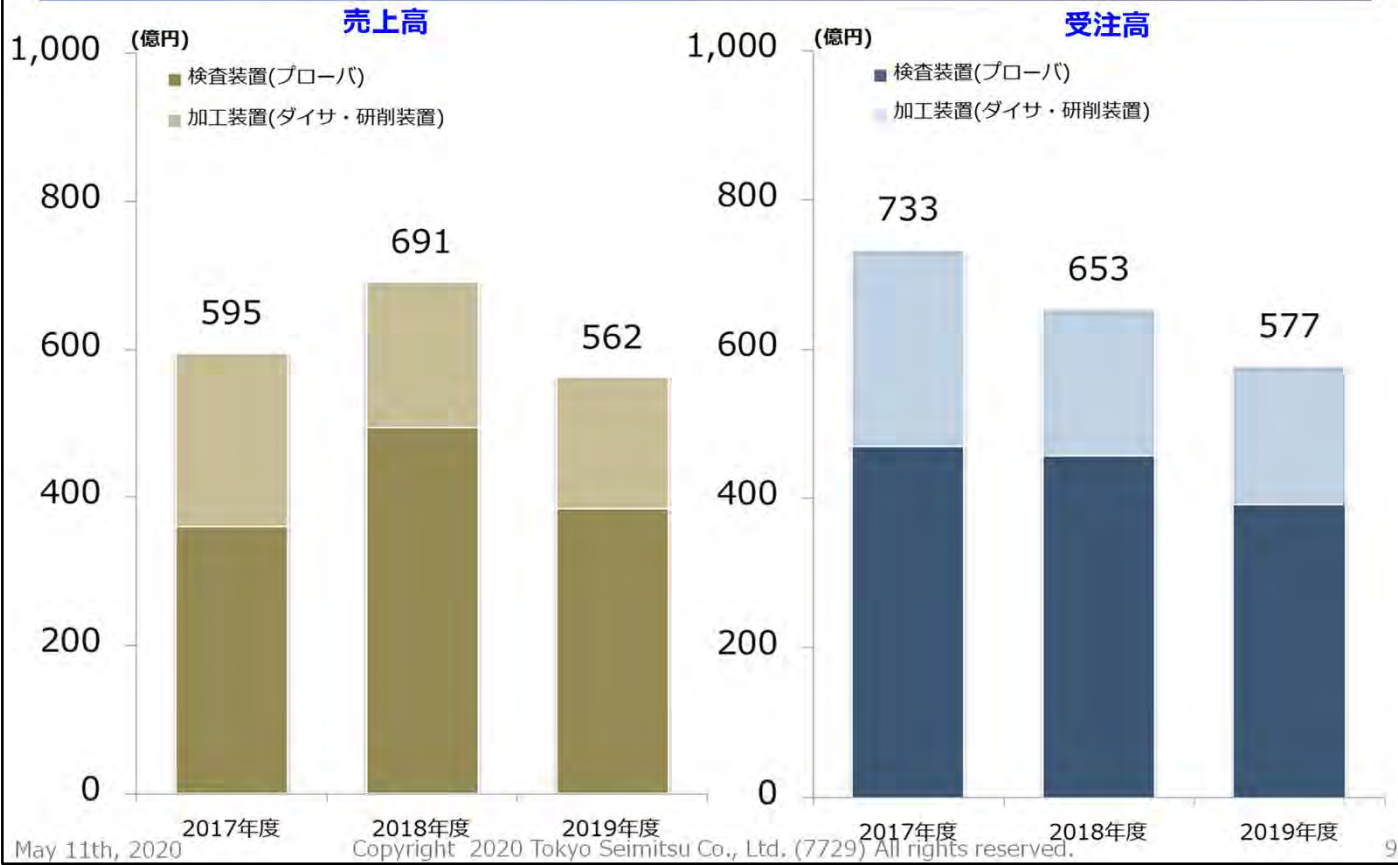
May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

8

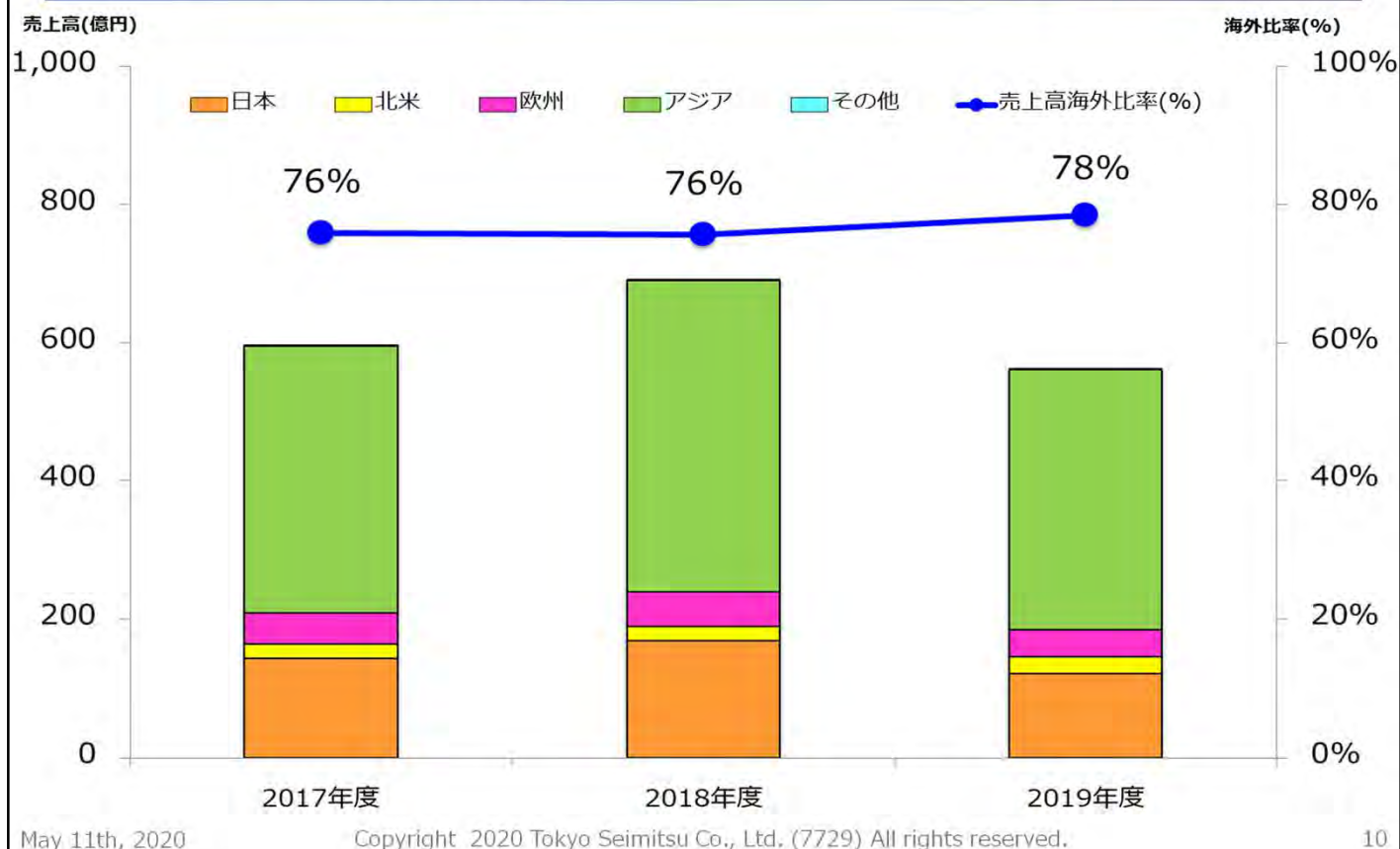
- 4Q受注は当初想定(3Q比微増)を上振れ, 5G関連, データセンター, 電子部品が牽引
- 新型コロナウイルスによる受注のものへの影響は軽微, その一方 出荷の期ずれが発生し, 受注残高が増加

半導体 - 製品別動向



- 2019年度の製品別比率：売上高, 受注高 ともに
検査装置(プローバ) 6割後半, 加工装置(ダイサ・研削装置) 3割前半

半導体 - 地域別売上高



- 2019年度の海外売上比率は78%
期を通じて中国向け売上が堅調、アジア向け売上が高水準

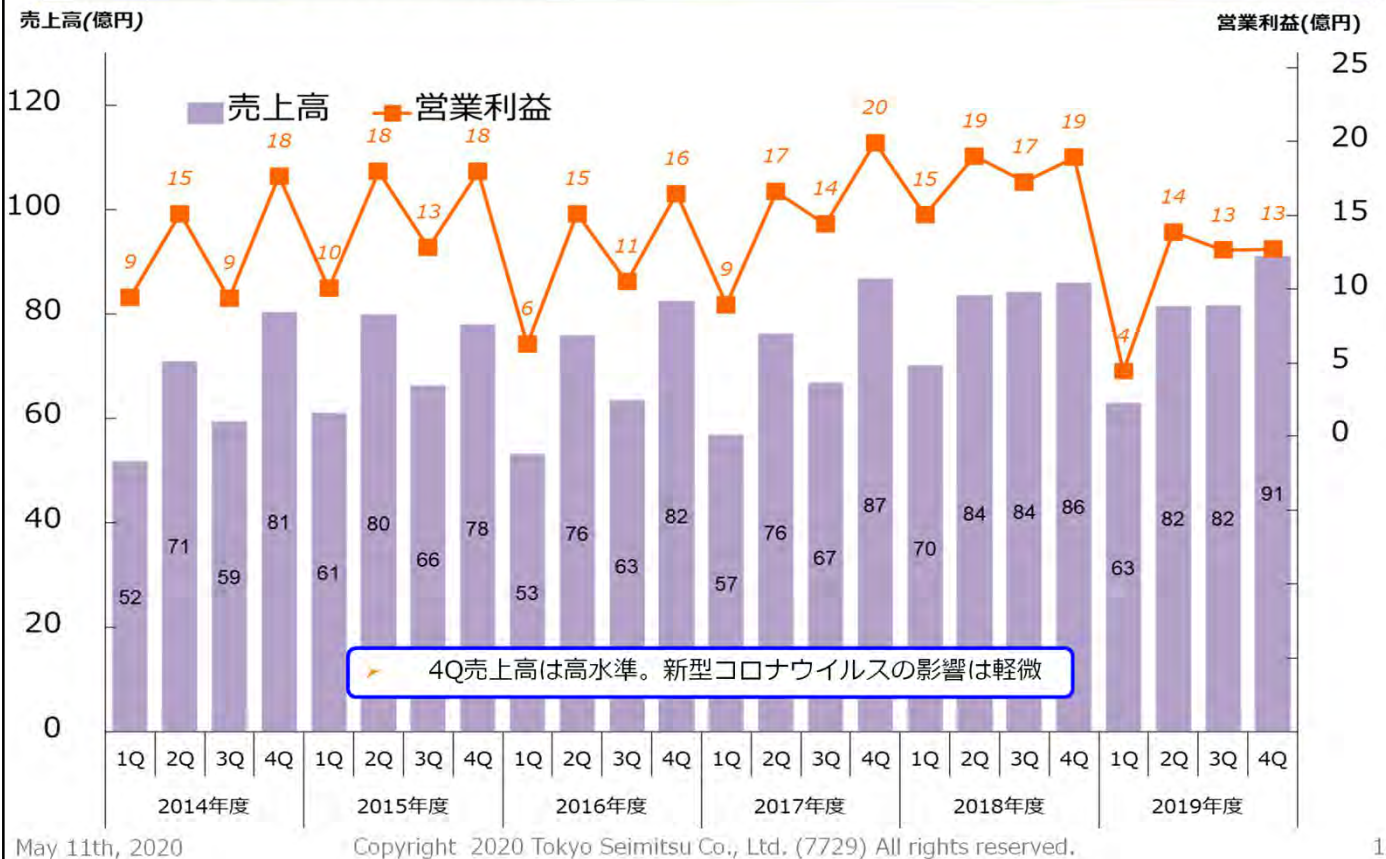
セグメント業績 (通期：億円)	2018年度		2019年度		
	通期		通期	予想対比	前年同期比
受注高	336		299		-11%
売上高	324		317	+7	-2%
営業利益 (営業利益率)	70 (22%)		44 (14%)		-38%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	89	86	89	72	80	74	71	74	+4%	+2%
売上高	70	84	84	86	63	82	82	91	+12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	15 (21%)	19 (23%)	17 (21%)	19 (22%)	4 (7%)	14 (17%)	13 (16%)	13 (14%)	+0%	-33%

- 売上高は想定を若干上振れ,受注高は想定を若干下振れ
- モノづくり全般の設備需要減速が続く
- 1Qの一過性費用, 充放電試験システム事業の開発/改革費用が営業利益を押し下げ

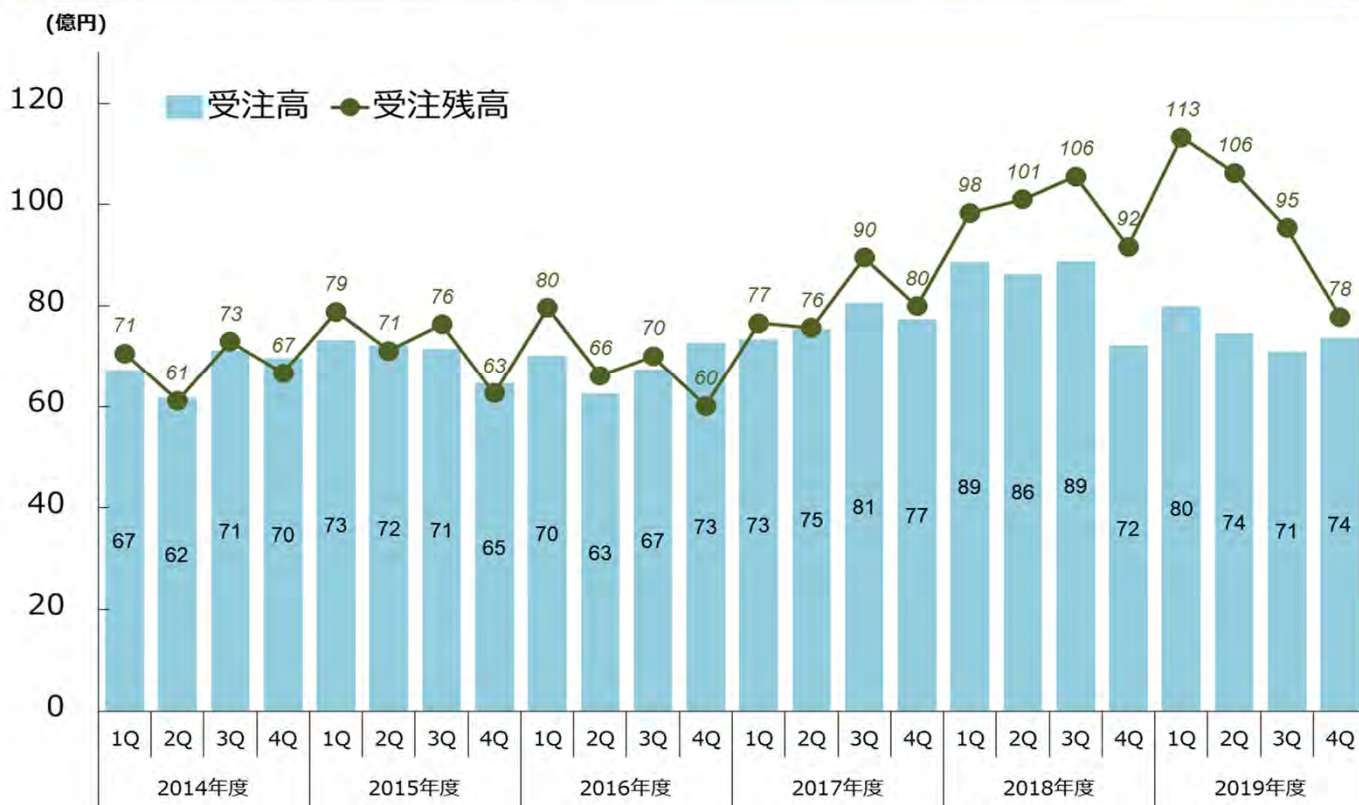
- 売上高は想定を上振れ
- 受注高は, モノづくり全般の設備需要減速が続き, 想定を下振れ
- 減収の他, 一過性費用などが営業利益に影響

計測 - 売上高, 営業利益



- 4Qは出荷が順調に進み、四半期売上は高水準
- 新型コロナウイルスの影響は軽微

計測 - 受注高, 受注残高

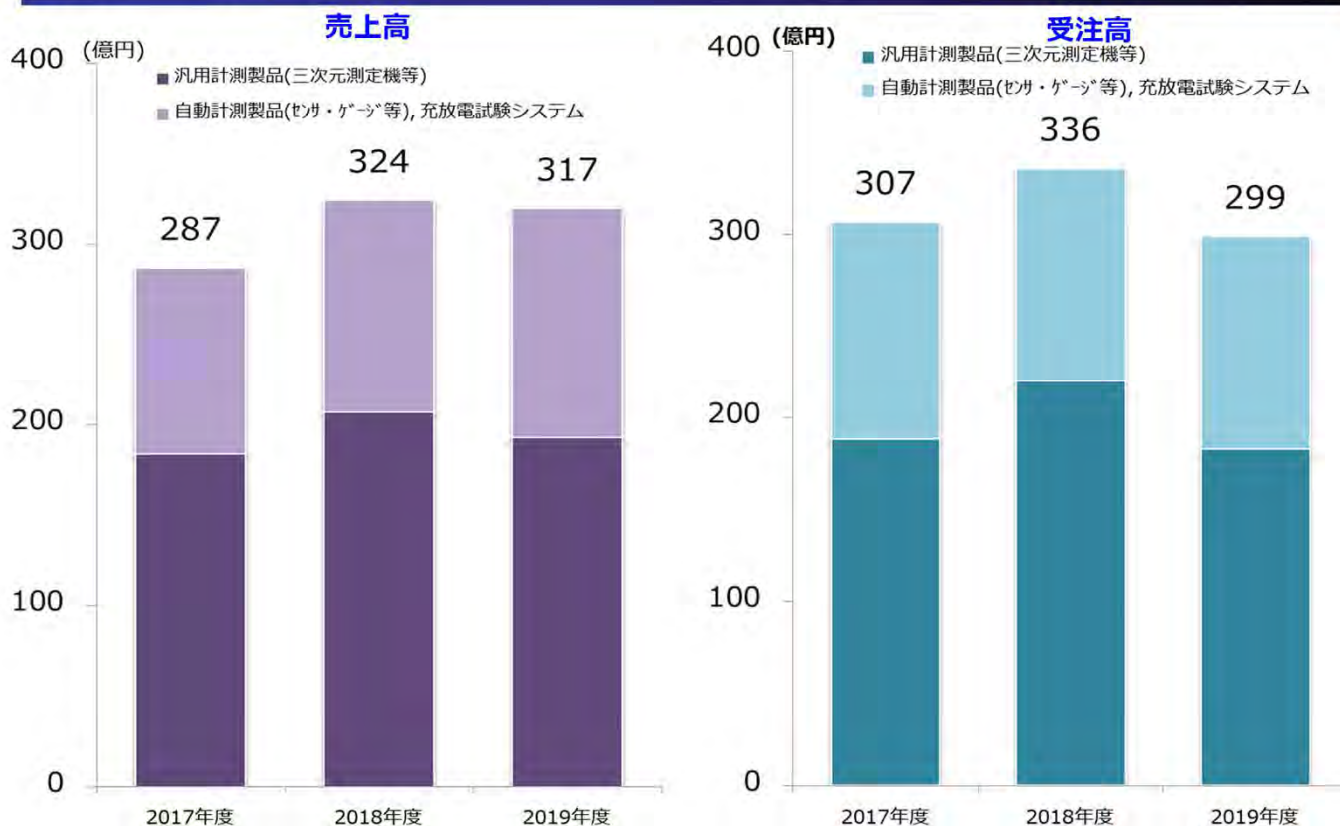


May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

13

- モノづくり関連需要全般が低迷し、4Q受注は想定を下振れも、3Q並みを維持
- 4Qの出荷が堅調だったため、受注残高は減少



May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

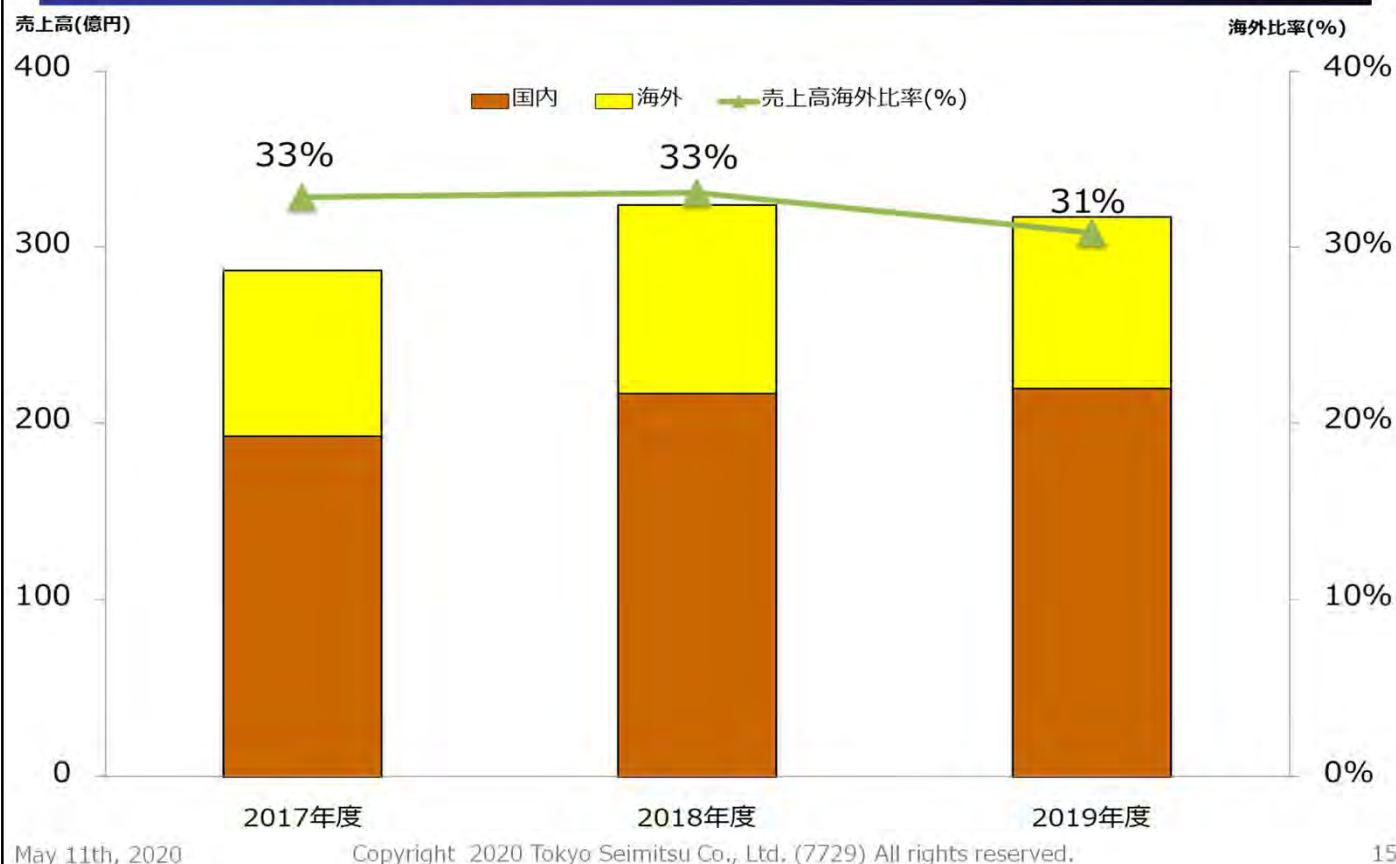
14

○ 2019年度の製品別比率：

売上高： 汎用計測 6割, 自動計測・充放電 4割

受注高： 汎用計測 6割前半, 自動計測・充放電 3割後半

計測 - 地域別売上高

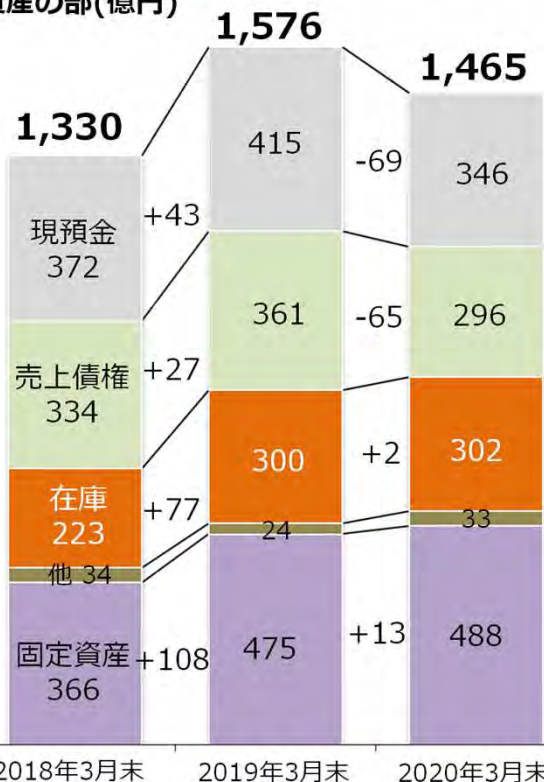


- 2019年度の海外売上比率は31%
国内売上は前年並みを維持も、海外売上が減少

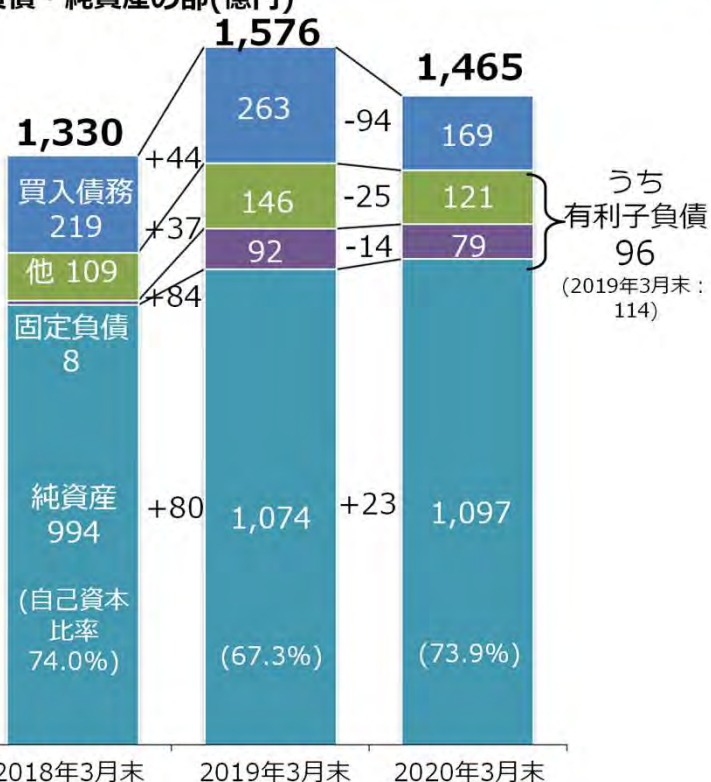
貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)

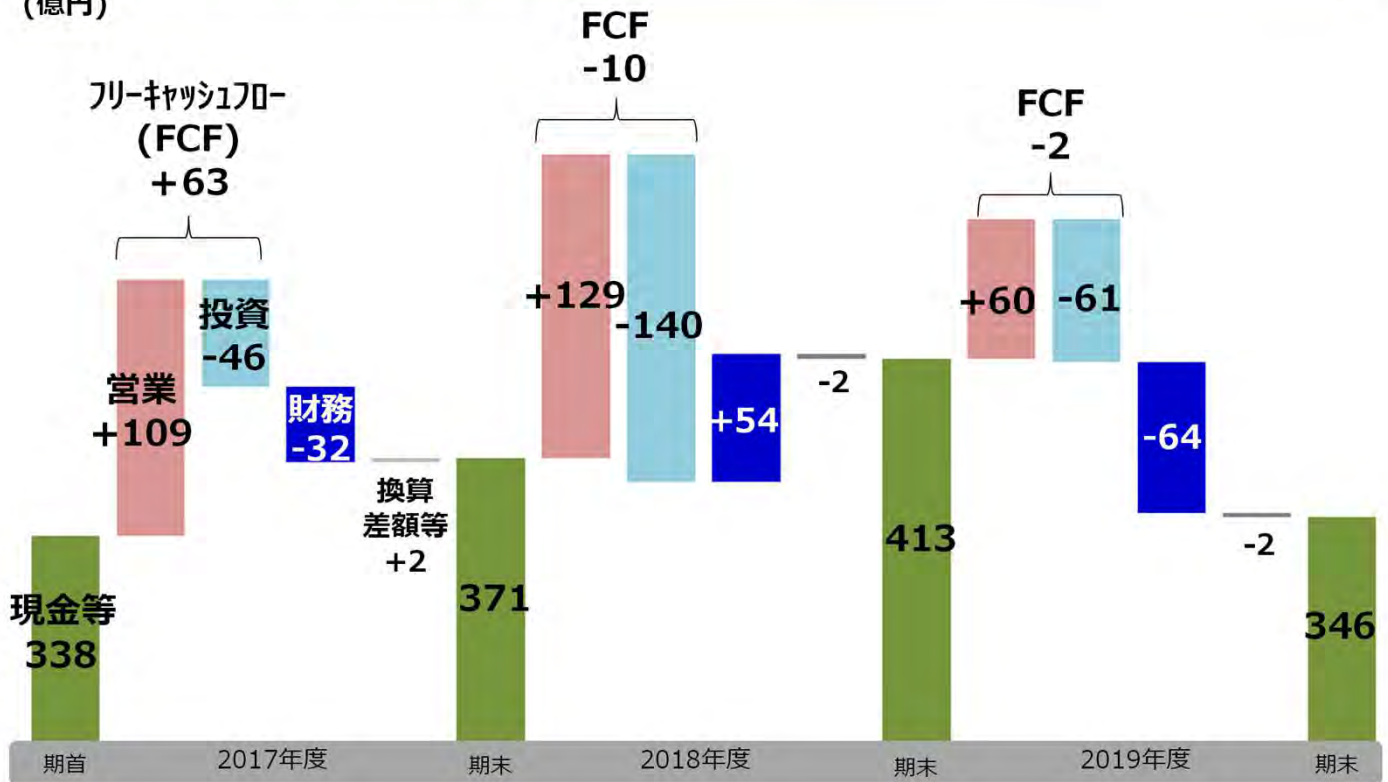


- 3月末の総資産は1,465億円(前年3月末比110億円減)
- 資産の部(左側) 増減の内訳は、現預金69億円、売上債権65億円 それぞれ減少、在庫2億円、他流動資産9億円、固定資産13億円 それぞれ増加
- 負債・純資産(右側) 増減の内訳は、買入債務94億円、その他流動負債25億円、固定負債13億円 それぞれ減少の一方、純資産は23億円増加
- 3月末の自己資本比率は73.9%、有利子負債残高は96億円

キャッシュフロー(CF)



(億円)



May 11th, 2020

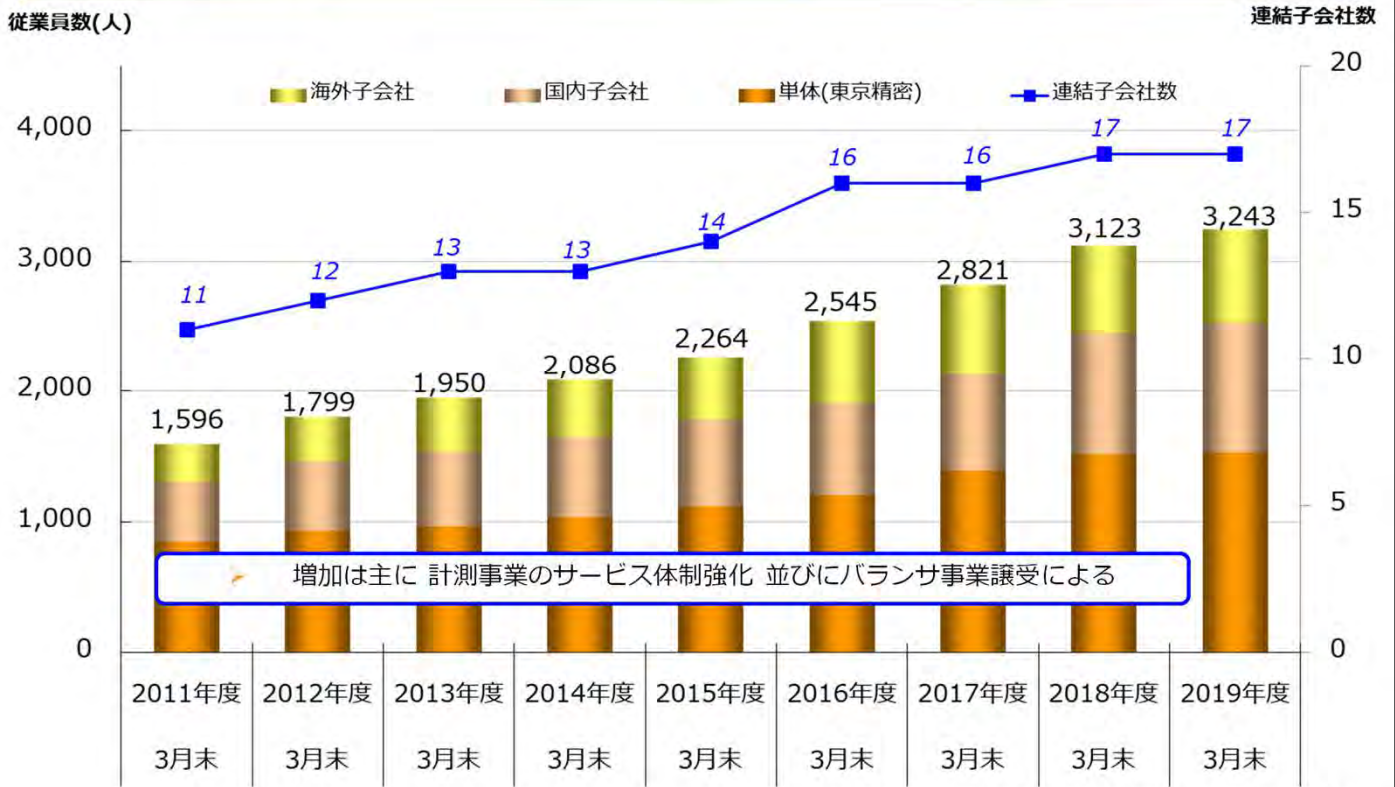
Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

17

- 2019年度キャッシュフロー(以下CF)
 - 営業CFは60億円のプラス(利益計上並びに売掛, 買掛などの増減が主因)
 - 投資CFは61億円のマイナス(設備投資等が主因)
 - この結果, フリーCFはマイナス2億円
 - 財務CFは64億円のマイナス

- この結果, 2019年度末の現金等の残高は346億円となった

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算

- 3月末の連結従業員数(正社員+期末臨時従業員)は3,243名
- 計測のサービス体制強化, 並びにバランサ事業の譲受を主因に, 前年3月末対比 120名増加

次第

- ◆ 2019年度 業績説明
- ◆ **中期目標 2年目総括**
- ◆ 中期目標 最終年度にあたって
- ◆ 2020年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円
(2020年度迄に)

両輪にて達成

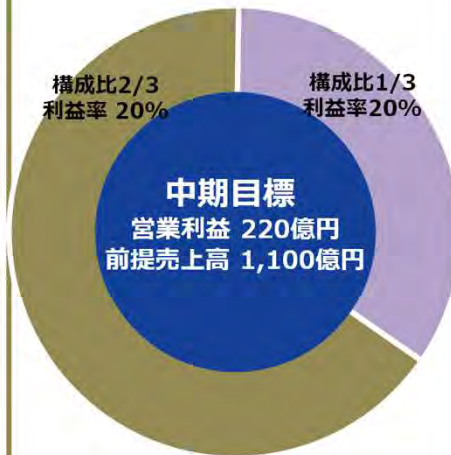
売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標: ROE 10%以上維持
- 中期目標: 2020年度迄に営業利益220億円達成
- 売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す

半導体製造装置

- 検査装置(プローバ)の“デパート化”戦略継続による 更なる市場拡大
- 加工装置の アプリケーション力強化・連動したサービスビジネス並びに消耗品売上の拡大
- 内製化促進, 新工場運用



計測機器

- 電気計測 (充放電試験) 進出による 対象市場拡大, シナジーの最大化
- 既存製品群の 差異化・国内外顧客開拓と, 連動したサービスビジネスの拡大
- 生産効率化・自動化



May 11th, 2020

Copyright 2020

Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

All rights reserved.

21

- 中期目標の前提となる売上高・利益構成並びに戦略は上記の通り
半導体で1/3,計測で1/3,利益率はともに20%を目指すもの
- 半導体では, 今後加速化が予想される市場の拡大を控え,
製品やアプリケーション/サービスの対応力と, キャパシティを十分に備えることに注力
- 計測では, 自動車EV化の動きを前にして, 電気計測分野へ進出
これにより, 当社の事業領域の拡大とシナジーの最大化を目指す

「準備」を着実に推進

定量面



前期比減収減益も、年度半ばから半導体の受注回復

技術面



高剛性研削盤、バルンサーなどの展開

生産面



両事業におけるキャパシティ拡充が進展

利益率
改善



ERP安定稼働, 効率化へ

- 中期目標の2年目の総括は表記の通り
- 定量面：減収減益も、半導体受注回復により、今後の売上拡大が期待できる結果
- 技術面：将来を見据えた 高剛性研削盤の新製品, 米国SMIT社バルンサー事業譲受などでラインアップの拡大を図った
- 生産面：将来を見据えたキャパシティ拡張を進めた
- 利益率改善：ERPを計画とおり稼働, 現在 効率化の取り組みを進めている

キャパシティ拡充(半導体：日野工場, 美山工場)

- 美山工場はフル稼働継続
- 日野工場 新棟建設マイルストーン作成
2022年度竣工予定



キャパシティ拡充 (計測：土浦MI棟)

- 2020年5月竣工
- 各種効率化・改善策を
推進



MI: *Monozukuri Innovation*

効率化

- ERP 安定稼働
- 業務改善・効率化

アプリ対応強化 (台湾新アプリセンター設立)

- 2020年度竣工予定



アプリ対応強化 (大阪計測センターリニューアル)

- 2020年1月竣工

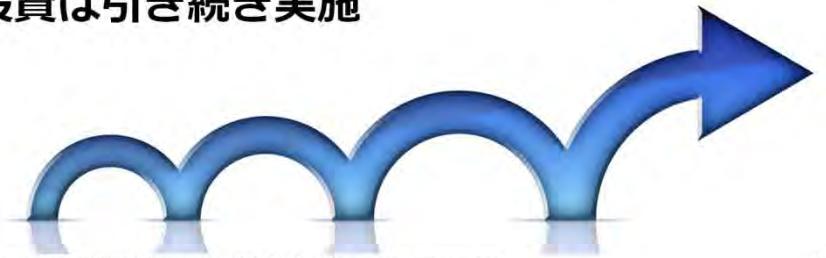


- キャパシティ拡充(上段)は, 半導体・計測双方で計画進行中
半導体：東京都八王子市 美山工場 フル稼働継続, 日野工場 新棟 2022年度竣工予定
計測：茨城県土浦市 土浦工場敷地内 新棟 5月竣工
- 効率化(下段左)は, ERPが安定稼働しており, 業務・周辺システムの改善を通じた
効率化の取り組みを進めている
- アプリケーション対応強化(下段中央, 右) は, 計画通り進行中

決算説明電話会議 次第

- ◆ 2019年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2年目総括
- ◆ **中期目標 最終年度にあたって**
- ◆ 2020年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

- 2020年度の事業環境は 当初前提より大きく変化
 - 全体 : 新型コロナウイルス感染症による世界経済の減速
 - 半導体 : 5Gを中心とした足許需要は堅調も, 動向を注視
 - 計測 : 当初想定より軟調に推移し, 回復時期が後ずれ
- リスク要因 (新型コロナ, 米中貿易摩擦) を注視しつつ, 中期目標達成に向けた「ジャンプアップの年」との位置づけ
- 堅調な半導体需要を取り込み, 2020年度は中期目標達成を目指す
- 両事業の成長に向けた投資は引き続き実施



- 足許の市場環境は, 中期目標策定時から大きく変化
当社はリスクを注視しつつも、2020年度を、中期目標達成を目指す
ジャンプアップの年と位置付ける
- 加えて, 長期的には底堅い需要が見込まれることから, 必要な投資を継続する

世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の 商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく

Growing together with partners and customers by collaborating technology,
knowledge and information to create the world's No.1 products.

理念を示すモットー

「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

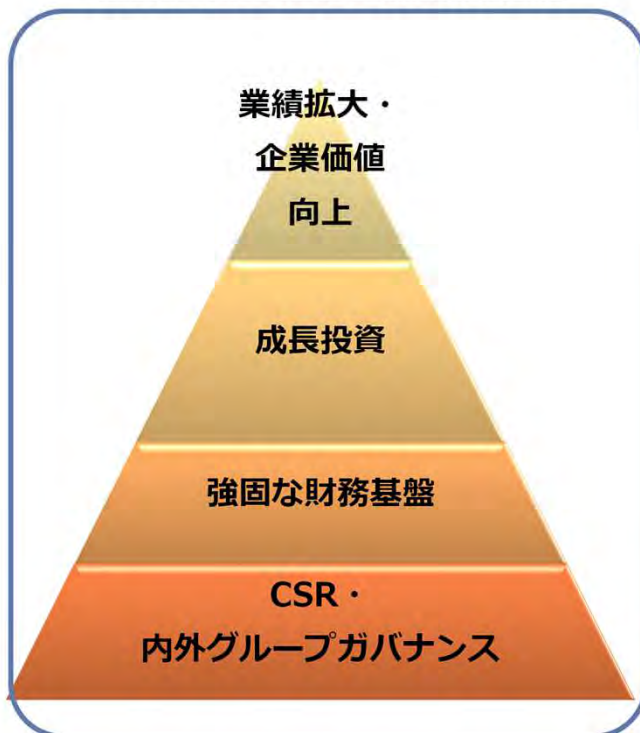
コーポレートブランド



“Accrete (共生)” と “Technology(技術)” の合成語

- 中期目標, さらに将来の成長のベースにある
当社の企業理念や枠組みに変化はない
- 企業理念は, 「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して
世界No.1の商品を創り出し, 皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー, 及びコーポレートブランド
「ACCRETECH (アクレーテク) 」を掲げ, 理念の実現に取り組んでいる

企業理念実現のための枠組み



当社事業構成の特徴



- 理念実現のための枠組みや、事業構成の持つ強みの認識なども変更なし
- 理念実現のための枠組み :
CSRやガバナンス, 強固な財務基盤をベースとして成長投資を継続し, 業績拡大と企業価値の向上を実現する
- 当社事業構成の持つ強み :
半導体事業の精密位置決め制御技術や内製化,
計測事業の高精度及び高分解能を実現する測定技術とその信頼性
需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が全社業績安定に寄与

技術面

製品競争力強化, 対象市場拡大

生産面

生産能力拡充, 効率改善(自動化, 省人化)

利益率改善

情報共有化促進
サービス, 消耗品売上の拡充

中期目標達成

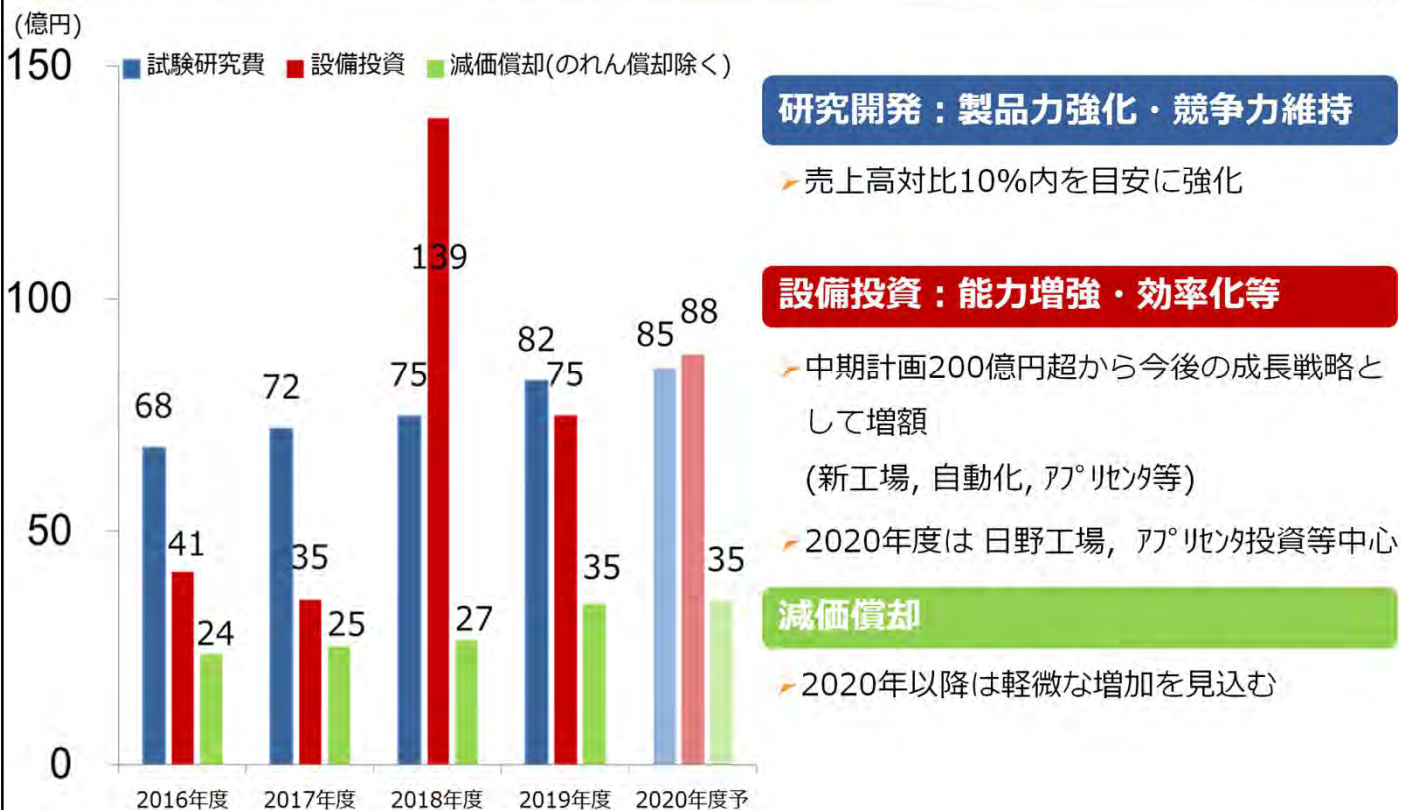


持続的な成長のために

積極的にESG活動を推進し, 企業価値向上を図る

- 当社の全社戦略は記載の通り、従前より変更はない
- 技術面: 既存製品の競争力を更に高め, 対象市場を更に拡大させる
- 生産面: 生産キャパシティの拡充と生産効率の改善を図る
- 利益率改善: 情報共有化の推進, 消耗品売上の拡充
- これらの目標達成を含めた持続的な成長のための基盤として ESG活動を積極的に推進したい

試験研究費, 設備投資, 減価償却



May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

29

- 試験研究費：売上高対比10%を目安に強化,
2019年度実績82億円, 2020年度計画85億円
- 設備投資：中期計画で200億円超から,今後の成長戦略として増額
2019年度は計測新工場やアプリセンタ投資が主体, 実績75億円
2020年度計画 88億円
- 減価償却：2019年はERP稼働を主因に 実績35億円, 2020年度計画35億円



- 持続可能な社会の実現に向けた、当社の目指すステークホルダーとのかかわりと、それぞれに対する目標は記載の通り
- 当社グループは、今後もお客様の新しい挑戦を支援する強力なパートナーであり続け、サプライヤとの協働で共に成長し続けるために、従業員の能力開発を進め、各ステークホルダーとのコミュニケーションを更に進化させていきたい

Environment(環境)

- 環境配慮型製品の開発 : LCA を考慮した開発を継続
- 温暖化防止 : 一部電力を低炭素電力へ切り替え, CO2排出削減
- 資源削減 : 水使用量・紙使用量低減, 廃棄物リサイクル率向上

LCA : Life Cycle Assessment

Social (社会)

- 職場環境の充実 : 働き方改革, 女性活躍推進, 健康企業宣言
- 品質, 安全 : QMS活動による品質改善, 安全教育の展開
- サプライチェーン : サプライヤと協働でのCSR活動推進

Governance(ガバナンス)

- コンプライアンス : 遵守体制・情報セキュリティ体制の強化
- リスクマネジメント : 事業継続計画(BCP) の強化



2020年度も, 持続可能な社会の実現に向け, 各活動を推進する

- 2019年度のESG活動総括と今後の取り組みについて
- 環境面 : 一例として、2020年3月に八王子工場の一部電力を再生エネルギー電力へ切り替え、CO2排出量 従来比半減の試算
- 社会面 : 女性活躍推進に注力、また2019年10月に健康企業宣言を内外に向けて行った
- ガバナンス面 : コンプライアンス順守体制、BCPの強化を実施
- 2020年度も、ブレイクダウンされた各計画を進め、持続可能な社会の実現に取り組む

次期 中期目標の前提(半導体)



- 5G普及により, 半導体・電子部品の 桁違いの大量生産・大量消費の時代へ
- その結果, 後工程SPEの重要性が高まると予想
- 業績拡大の軸は, 引き続き 開発強化と生産キャパシティ拡張



May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

32

- 現在の中期目標の次に策定すべき 中期目標の前提となる考え方 (半導体)
- 5G普及によるデータ量の飛躍的な増加は、半導体・電子部品の大量生産・大量消費につながる
- また前工程の技術的な制約から、後工程の重要性が生産性・機能の両面で高まる
- その結果加工装置の需要増加、検査装置の安定した市場が期待できる
- このため、当社としては、製品開発強化、キャパシティ拡充を軸とした戦略をとる

- 内燃機関の測定需要は、新エネルギー車(NEV)の広まりを受け、緩やかな減少を見込む
- 他方で、自動化(IoT)と、NEV バッテリ + モータ測定需要に大きな期待
- 業績拡大の軸は、製品ラインナップおよび参入分野の拡大と、海外売上増加



- 自動車内燃機関測定需要は、NEVの広まりを受け、緩やかな減少を予想
- 他方で、計測自動化、NEV関連測定の盛り上がり期待
- 加えて、非自動車/成長業界考えられる半導体・航空機・医療などの需要にも期待
- 当社としては、製品ラインナップおよび参入分野の拡大と、海外売上増加を軸とした戦略をとる

決算説明電話会議 次第

- ◆ 2019年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2年目総括
- ◆ 中期目標 最終年度について
- ◆ **2020年度 業績予想**
- ◆ 質疑応答

全体

- 新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な状況下、下期以降の見通しは現時点では困難

半導体

- 5Gを中心に足許需要は堅調も 今後の動向を注視
- 来たる市場拡大に備え、必要な研究開発・設備投資を継続

計測

- モノづくり関連需要の立ち上り時期が後ずれ
- 半導体, NEV, 医療分野への拡販を推進

- 2020年度の業績予想の前提
- 全体として、新型コロナウイルスの収束次期不透明であり、下期以降の見通しが困難
- 半導体：足許の受注環境は5Gを中心に堅調、ただし今後の動向を注視
中長期的な成長に備えての投資を継続
- 計測：コロナ影響により、モノづくり関連需要の回復が後ずれする懸念がある
一方で、新しい市場への拡販を推進する

2020年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2019年度			2020年度	
	上期	下期	通期	上期予	前年同期比
売上高	420	459	879	470	+12%
営業利益 (営業利益率)	56 (13%)	67 (15%)	123 (14%)	76 (16%)	+36%
経常利益	57	66	124	76	+32%
当期純利益	43	29	72	56	+31%
1株配当			76円		未定

セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	229	348	577		
	売上高	276	286	562	355	+29%
(計測)	受注高	154	145	299		
	売上高	144	173	317	115	-20%

- ▶ 通期業績予想ならびに配当予想は、公表が可能となったタイミングで速やかに開示予定

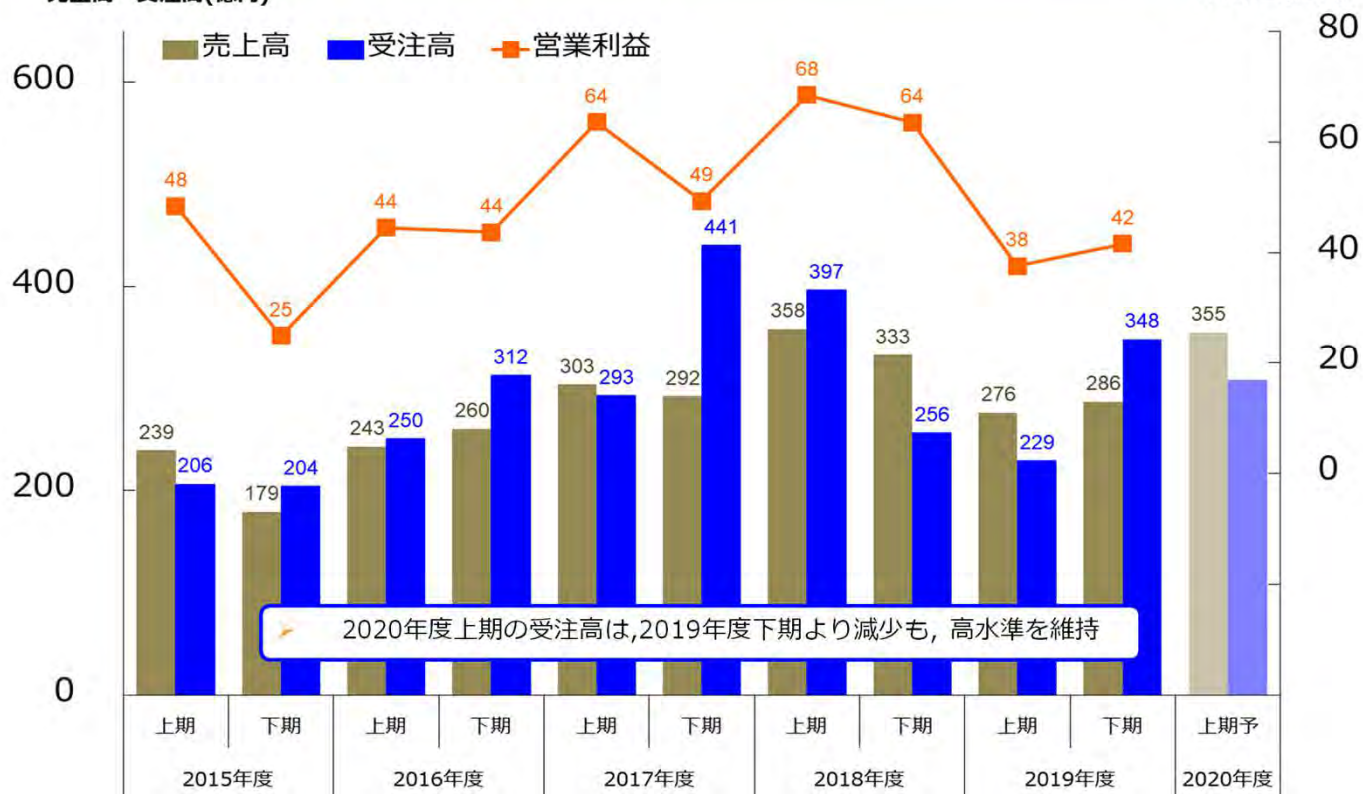
- 2020年度予想は、現時点では上期のみ発表する
- 2020年度上期予想は、売上高470億円、(うち半導体 355億円、計測115億円)、営業利益76億円、経常利益76億円、純利益56億円、年間配当 未定
- 通期業績予想、並びに配当予想は公表が可能となったタイミングで開示予定

半導体 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



2020年度上期の受注高は、2019年度下期より減少も、高水準を維持

May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

37

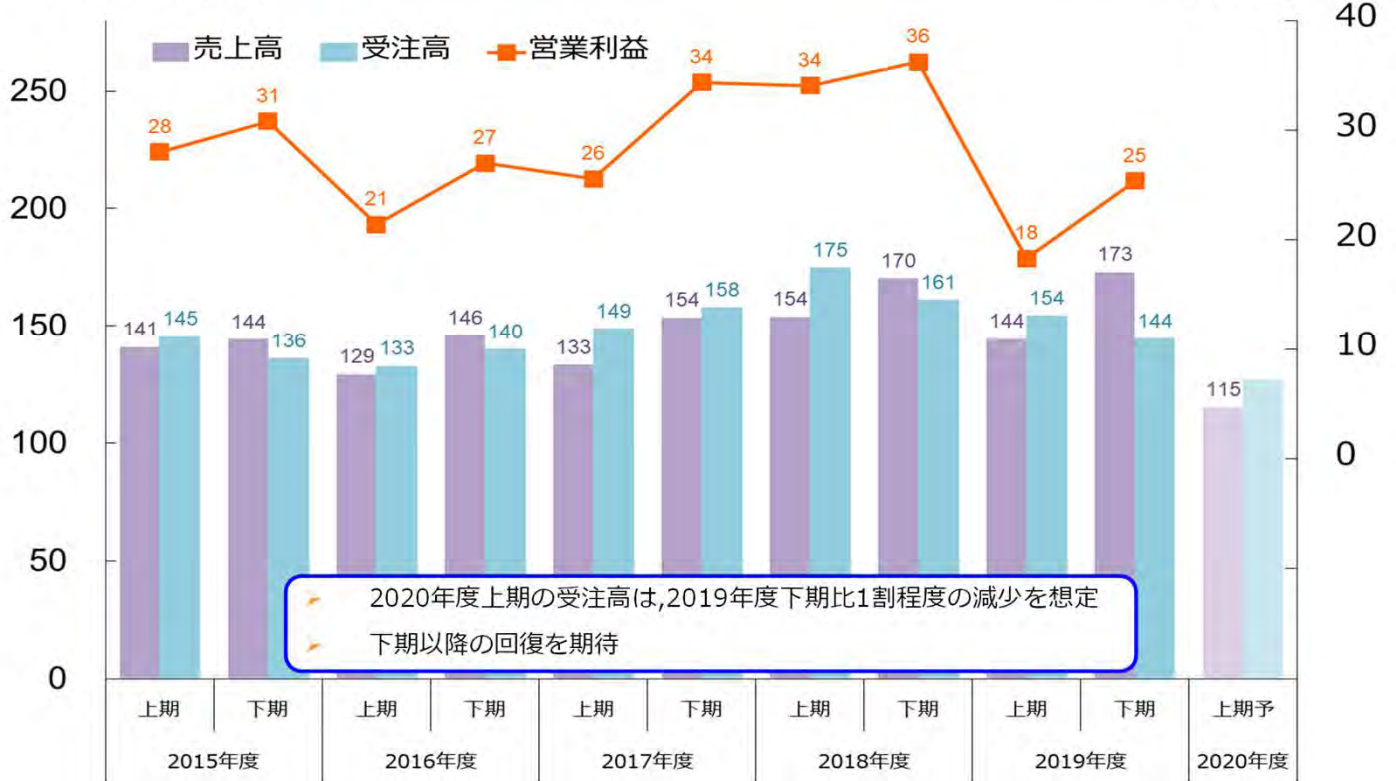
- 2020年度上期の半導体受注高は、前下期比減収も、高水準を維持する見通し
- 2020年度上期の製品構成比の想定
 - 売上高：検査装置7割, 加工装置3割
 - 受注高：検査装置6割前半, 加工装置3割後半

計測 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



May 11th, 2020

Copyright 2020 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

38

- 2020年度上期の計測受注高は、前下期10%程度の減少を想定
- 2020年度上期の製品構成比の想定
 売上高・受注高共に：汎用計測製品 6割半ば、加工装置3割半ば

決算説明電話会議 次第

- ◆ 2019年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2年目総括
- ◆ 中期目標 最終年度について
- ◆ 2020年度 業績予想
- ◆ **質疑応答**



<https://www.accretech.jp/>
<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>



補足資料

セグメント別業績推移



(百万円)	会計期間				四半期								
	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2019年3月期				2020年3月期				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
受注高	半導体	56,232	73,327	65,335	57,709	19,339	20,360	15,120	10,515	10,694	12,177	15,375	19,462
	計測	27,254	30,651	33,573	29,866	8,859	8,621	8,880	7,212	7,974	7,446	7,086	7,359
	合計	83,487	103,979	98,909	87,576	28,199	28,981	24,000	17,727	18,668	19,624	22,461	26,821
受注残高	半導体	17,647	31,452	27,670	29,182	37,969	35,333	35,152	27,670	26,689	22,991	24,303	29,182
	計測	6,015	7,996	9,165	7,782	9,837	10,100	10,555	9,165	11,333	10,623	9,538	7,782
	合計	23,663	39,448	36,836	36,965	47,806	45,434	45,707	36,836	38,022	33,615	33,842	36,965
売上高	半導体	50,291	59,523	69,117	56,198	12,822	22,996	15,301	17,996	11,676	15,874	14,063	14,583
	計測	27,501	28,671	32,403	31,728	7,018	8,357	8,426	8,601	6,285	8,157	8,170	9,115
	合計	77,792	88,194	101,520	87,927	19,841	31,353	23,727	26,598	17,962	24,031	22,233	23,698
営業利益	半導体	8,820	11,292	13,195	7,915	1,630	5,215	3,053	3,296	1,358	2,399	2,111	2,046
	計測	4,839	5,990	7,025	4,366	1,503	1,901	1,727	1,893	443	1,387	1,265	1,270
	合計	13,659	17,283	20,221	12,282	3,134	7,116	4,780	5,190	1,802	3,786	3,376	3,317
営業利益率	半導体	17.5%	19.0%	19.1%	14.1%	12.7%	22.7%	20.0%	18.3%	11.6%	15.1%	15.0%	14.0%
	計測	17.6%	20.9%	21.7%	13.8%	21.4%	22.8%	20.5%	22.0%	7.1%	17.0%	15.5%	13.9%
	合計	17.6%	19.6%	19.9%	14.0%	15.8%	22.7%	20.1%	19.5%	10.0%	15.8%	15.2%	14.0%

損益計算書



(百万円)	会計期間				四半期							
	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2019年3月期				2020年3月期			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	77,792	88,194	101,520	87,927	19,841	31,353	23,727	26,598	17,962	24,031	22,233	23,698
売上原価	48,152	53,818	60,430	53,452	11,933	18,926	13,614	15,954	10,862	14,687	13,357	14,544
売上総利益	29,640	34,375	41,090	34,474	7,907	12,426	10,112	10,644	7,100	9,344	8,876	9,154
販売費および一般管理費	15,981	17,092	20,869	22,192	4,773	5,309	5,331	5,454	5,297	5,557	5,499	5,837
営業利益	13,659	17,283	20,221	12,282	3,134	7,116	4,780	5,190	1,802	3,786	3,376	3,317
営業外収益	318	170	688	255	235	303	29	121	131	78	102	-57
営業外費用	112	138	104	176	14	8	11	69	38	18	51	67
経常利益	13,864	17,316	20,805	12,361	3,354	7,411	4,798	5,241	1,895	3,846	3,426	3,192
特別利益	583	4	58	57	2	-	-	55	2	10	43	1
特別損失	32	2	419	1,712	-	-	-	419	-	-	42	1,669
税引前利益	14,415	17,318	20,443	10,706	3,357	7,411	4,798	4,877	1,897	3,856	3,427	1,524
法人税等合計	4,464	4,542	5,719	3,598	790	2,056	1,290	1,582	505	1,009	1,153	930
親会社株主に帰属する 当期純利益	9,909	12,717	14,665	7,157	2,551	5,340	3,484	3,288	1,402	2,859	2,281	614
1株当たり当期純利益(円)	239.32	306.41	352.92	171.92	61.43	128.52	83.84	79.13	33.70	68.69	54.80	14.73
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円)	237.80	304.02	350.23	170.74	-	-	-	-	-	-	-	-

貸借対照表



(百万円)		2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
流動資産	現金及び預金	33,853	37,220	41,518	34,640
	売上債権※1	28,409	33,439	36,146	29,633
	在庫	17,313	22,325	29,995	30,152
	その他	3,215	3,364	2,434	3,345
	合計	82,792	96,349	110,094	97,771
固定資産合計		31,670	36,645	47,478	48,777
総資産		114,463	132,995	157,573	146,549
流動負債	買入債務※2	15,789	21,870	26,328	16,895
	その他	10,781	10,936	14,620	12,121
	合計	26,570	32,807	40,948	29,017
固定負債合計		698	833	9,220	7,857
負債合計		27,269	33,640	50,169	36,874
純資産合計		87,194	99,354	107,403	109,674
負債・純資産合計		114,463	132,995	157,573	146,549
有利子負債合計		1,332	1,351	11,415	9,641
自己資本比率		75.5%	74.0%	67.3%	73.9%
自己資本利益率(ROE)		12.0%	13.8%	14.4%	6.7%

※1: 電子記録債権を含む ※2: 電子記録債務を含む

各種費用, キャッシュフロー



(百万円)	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
試験研究費	6,791	7,194	7,469	8,234
設備投資	4,145	3,547	13,872	7,477
減価償却費(のれん除く)	2,380	2,541	2,655	3,450

(百万円)	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期
営業活動によるキャッシュフロー	12,809	10,931	12,932	5,965
投資活動によるキャッシュフロー	-3,486	-4,649	-13,952	-6,116
フリーキャッシュフロー	9,322	6,281	-1,020	-150
財務活動によるキャッシュフロー	-2,953	-3,163	5,443	-6,375
現金及び現金同等物に係る 換算差額等	-130	147	-223	-159
現金及び現金同等物の期末残高	33,825	37,090	41,290	34,605